

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，故並無載列就閣下而言可能屬重要的所有資料。閣下於決定[編纂][編纂]前，務請閱覽整份文件。任何[編纂]均涉及風險。投資[編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下於決定[編纂][編纂]前應細閱該節全文。

概 覽

我們是誰

我們是一家領先的12英寸純晶圓代工企業，處於全球半導體價值鏈的關鍵環節。作為專業的晶圓代工服務供應商，代工企業將無晶圓、輕晶圓及垂直整合製造（「IDM」）公司的集成電路設計藍圖大規模地製成高品質的加工晶圓。

自成立以來，我們始終致力於製程技術的進步。我們的代工服務覆蓋150nm至40nm技術節點，截至最後實際可行日期已成功開發28nm邏輯芯片平台，使我們能應對對更高性能及更高能效半導體解決方案不斷演變的需求。我們的製程能力圍繞關鍵的特定應用集成電路類別，包括實現顯示控制的顯示驅動芯片（「DDIC」）、實現圖像傳感的互補金屬氧化物半導體圖像傳感器（「CIS」）以及調節及優化電源使用的電源管理集成電路（「PMIC」）。Logic IC（支持數據處理）及微控制單元（「MCU」，提供嵌入式控制）於往績記錄期間亦迅速增長。憑藉此產品組合，我們能夠支持消費電子、汽車電子、工業控制、人工智能（「AI」）、物聯網（「物聯網」）及存儲器等眾多應用。

我們將差異化製程技術與穩定製造規模結合的能力，鞏固我們於全球晶圓代工領域的地位。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年至2025年，全球前十大晶圓代工企業中，我們的產能及收入增長速度為全球第一。根據同一資料來源，於2025年，以收入計，我們為全球第九大、中國大陸第三大晶圓代工企業。

概 要

下表為我們的業務亮點：

高質量增長	行業領導地位	研發能力
 47.0% 2020年至2025年 收入年複合增長率 ⁽¹⁾	 中國大陸 第三 全球 第九 晶圓代工企業 ⁽²⁾	 1,374 項專利 包括 1,057 項發明專利 截至2025年12月31日
 22.7% 2025年綜合毛利率	 全球第一 DDIC晶圓代工企業 ⁽²⁾	 人民幣1,453.4百萬元 2025年研發開支
 32.2% 本公司擁有人應佔 淨利潤同比增速 ⁽³⁾	 中國大陸 第三 全球 第五 CIS晶圓代工企業 ⁽²⁾	 34.6% 截至2025年12月31日 研發人員佔員工總數比例

附註：

- (1) 根據我們自2020年至2025年於上海證券交易所科创板所刊發的年報數據。該等數字未經審計師及申報會計師審計或審閱。
- (2) 根據弗若斯特沙利文的資料，於2025年按營業收入排名。
- (3) 自2024年至2025年。

我們的業務模式

晶圓代工行業為全球半導體價值鏈的重要支柱。依託上游提供硅晶圓、光刻膠、特種化學品、核心設備、電子設計自動化工具及知識產權授權等必要材料及技術，晶圓代工企業為無晶圓、輕晶圓及IDM公司等集成電路設計公司提供專業的晶圓代工服務，將其集成電路設計藍圖大規模地製成高品質的加工晶圓。無晶圓公司將晶圓代工完全外包予晶圓代工企業，而具備內部集成電路製造能力的輕晶圓及IDM公司亦可與晶圓代工企業合作，以獲取專業技術、確保穩定產能並提升成本效益。該等加工晶圓隨後交付予集成電路設計公司，由半導體封測代工（「OSAT」）供應商進行封裝與測試，最終由集成電路設計公司整合至消費電子、汽車電子、工業控制、AI、物聯網及存儲器等廣泛應用領域的終端產品中。

在此價值鏈中，作為一家12英寸純晶圓代工企業，我們銜接技術發展與大規模生產，提供低功耗、高性能的集成電路。我們的技術平台組合提供代工服務，主要包括DDIC、CIS及PMIC，而Logic IC及MCU於往績記錄期間迅速增長。我們服務多元客戶群，包括消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲器等終端市場的無晶圓、輕晶圓及IDM公司等領先集成電路設計公司。

概 要

晶圓代工中，硅晶圓尺寸從最初的6英寸及8英寸發展至現時主流的12英寸。儘管8英寸生產線仍在支持傳統應用，但目前的增量產能增長主要來自12英寸晶圓，其表面面積為8英寸晶圓約2.25倍，良率相同時可切割出更多晶粒並降低單片晶圓成本。我們專門從事12英寸晶圓代工，實現高集成密度、緊湊組件設計及出色的電氣性能。

晶圓代工服務的技術成熟度通常體現在製程技術節點。根據弗若斯特沙利文的資料，7nm或以下的前沿節點用於高性能處理器、AI加速器、旗艦智能手機的系統級芯片（「SOC」）及先進網絡芯片，以解決計算密集型邏輯任務。介乎10nm至22nm的先進節點通常用於需要平衡性能及集成的應用，例如中端消費SOC、高端MCU、CIS及PMIC設計。工業控制、物聯網、顯示及功率器件等下游應用對半導體產品的長期可靠性及運作穩健性一向有持續且嚴格的要求，此亦支撐28nm及以上成熟節點的持續廣泛普及。就DDIC、CIS、PMIC及MCU等關鍵元件而言，成熟節點因其成熟且歷經充分驗證的製造流程而受廣泛青睞。使用該等成熟節點技術製造的芯片通常具備更厚的柵氧化層，可降低電場強度並提升電壓抗性。其相對較長的導電通道亦能在溫度與工作電壓變動下提供穩定的電氣性能。此外，成熟節點平台常集成專用的高壓元件結構，能有效分散電應力，從而在極長的運作生命週期中顯著提升元件可靠性。該等固有的技術特性使成熟節點成為安全型高壓應用的當然之選，從而維持殷切的市場需求。此外，行業表現通常基於晶圓銷量、產能及良率等關鍵運營指標進行評估。根據同一資料來源，截至最後實際可行日期，我們的全面晶圓代工服務組合涵蓋多個產品類別的技術節點，使我們於國內同業中處於領先地位，DDIC達至40nm，CIS及Logic IC達至55nm，PMIC及MCU達至110nm。

通過整合製程專業知識、良率優化及成本控制，我們提供的製造平台能夠使客戶加速產品週期、確保質量穩定並實現可擴展生產。憑藉本地化運營，我們進一步鞏固我們作為可信賴代工合作夥伴的地位，幫助客戶降低供應鏈風險，並保持其運營的穩定性及確定性。

我們的技術實力

我們已建立150nm至40nm技術節點的量產能力。在工藝平台應用方面，我們已具備DDIC、CIS、PMIC、Logic IC、MCU等工藝平台的技術能力，形成了全面且多元化的工藝組合，支持我們在關鍵細分市場的領先地位。我們不斷提升製程技術，進一步優化了產品結構。截至最後實際可行日期，我們已開始28nm Logic IC試產，實現40nm高壓有機發光二極管顯示驅動芯片（「OLED DDIC」，一種用於控制OLED面板、具有更高精度及能源效益的DDIC）、55nm中高階背照式圖像傳感器（「背照式圖像傳感器」，具有讓光線從硅基板的背面進入以提高靈敏度及性能的傳感器架構的CIS）及55nm全流程堆棧式CIS（其垂直集成多個傳感器層以提升圖像質量及功能）量產，並正在穩步推進OLED DDIC等其他28nm晶圓代工解決方案的開發工作。

概 要

我們的客戶群及供應商體系

依託堅實的技術基礎，我們獲得無晶圓、輕晶圓及IDM公司等領先集成電路設計企業的廣泛認可，並與多元化的客戶群體建立了長期而深入的合作關係。與戰略客戶的緊密協作，使我們能夠持續優化研發與代工流程，確保產品與服務時刻緊貼市場需求的演進。與此同時，我們依託穩健的供應商體系，積極提升國產設備與材料的應用比例，從而增強供應鏈韌性，並為半導體產業的本土化進程貢獻力量。

我們的財務表現

於往績記錄期間，我們於行業週期中貫徹展現出穩健的表現。於2023年、2024年及2025年，總收入分別為人民幣7,182.7百萬元、人民幣9,119.6百萬元及人民幣10,388.3百萬元，同年毛利率為20.3%、25.2%及22.7%。於2023年、2024年及2025年，淨利潤分別為人民幣119.2百萬元、人民幣482.2百萬元及人民幣466.5百萬元，同年淨利潤率為1.7%、5.3%及4.5%。

近年來，全球晶圓代工行業已經歷持續的長期增長及正常的週期性調整。在疫情後復甦及供應鏈緊張的推動下，於2021年及2022年下游半導體需求激增後，行業於2023年進入存貨正常化階段，原因為整個半導體價值鏈的客戶在消費電子產品需求疲軟的情況下專注於消化高存貨水平。儘管存在該暫時調整，全球晶圓代工市場整體持續擴張，由2021年約1,002億美元增長至2025年的1,747億美元，複合年增長率為14.9%。在此背景下，我們的收入於2023年至2025年有所增加，主要由市場需求增加、豐富產品組合及規模經濟效應提升所帶動。據弗若斯特沙利文告知，董事認為，我們的財務表現大致維持穩定，與整體市場動態一致。按此基準，獨家保薦人概不知悉有任何事宜令獨家保薦人不同意董事的意見。

展望未來，董事認為半導體市場的需求將維持強勁，尤其是在我們運營所在的成熟節點領域。支持性政府政策及結構性拓展的下游應用預計將支撐行業的穩定發展。具體而言，汽車電子、AI及機器人的增長不斷提升每件設備的半導體含量，其中PMIC、MCU及DDIC主要採用成熟節點製造，支持持續需求及穩健的供需動態。見「行業概覽—全球晶圓代工市場」。

我們的競爭優勢

我們相信，我們的業務成功及領先市場地位有賴以下主要優勢：(i)我們是快速成長的全球前十大晶圓代工企業，提供廣泛的工藝平台；(ii)我們與全球領先的芯片設計客戶建立了緊密穩固粘性強的業務關係；(iii)智能生產和本地化產業鏈優勢確保更高經營效率和成本效益；(iv)我們具備強大的研究及開發能力，可以持續進行技術產品迭代；及(v)我們擁有經驗豐富的管理團隊和多元完善的股東結構。見「業務—我們的競爭優勢」。

概 要

我們的戰略

我們計劃實施以下戰略，以鞏固及提升我們在行業中的領先地位：(i)多元工藝平台佈局，技術迭代打開新增長曲線；(ii)完善技術體系，高效研發引領持續創新；(iii)有序擴充產能，智能製造驅動生產效率提升；(iv)區位優勢轉化，產業鏈生態圈實現價值共生共贏；及(v)推進全球化戰略，國際化經營理念把握發展新機遇。見「業務－我們的戰略」。

我們的生產能力

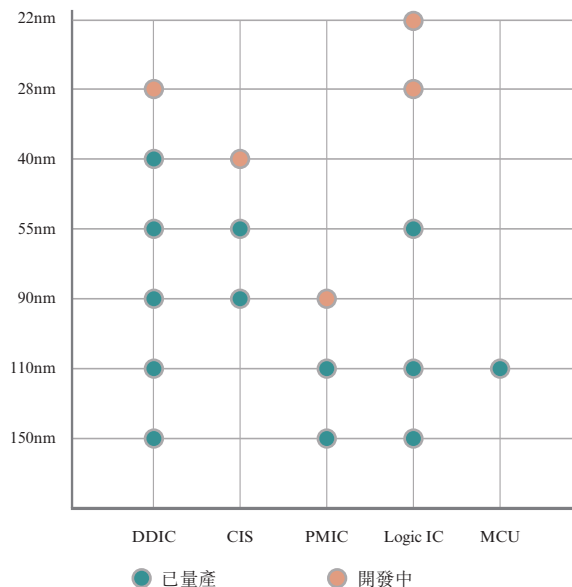
概覽

我們在安徽省合肥市經營一個專注於12英寸晶圓代工的大規模集成生產基地，將生產設施集中在單一製造園區內。截至2025年12月31日，生產基地的總建築面積約為387,007.6平方米，於2025年，12英寸晶圓的平均月產量為139.0千片。

我們的技術平台

我們的技術平台組合主要支持DDIC、CIS及PMIC代工，而Logic IC及MCU於往績記錄期間迅速增長。建基於150nm至28nm的多元化技術節點，每個平台均配置應用特定的製程模組及豐富的器件選項，例如高壓晶體管、嵌入式非易失性存儲器及成像結構，以滿足不同終端應用的功能需求，提高產品性能、成本效益及設計靈活性。該等平台構成代工服務的基礎，使我們能夠在廣泛的應用中提供最佳的功率性能、全面提升的處理速度、集成密度及可製造性。

下圖列示我們截至最後實際可行日期主要技術平台的開發狀況：



概 要

下表載列我們於所示年度按技術節點劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
	(人民幣千元，百分比除外)					
150nm.....	960,726	13.4	1,409,180	15.5	1,979,799	19.1
110nm.....	2,188,688	30.5	2,446,519	26.8	2,796,822	26.9
90nm.....	3,469,754	48.3	4,362,854	47.8	4,461,425	42.9
55nm及以下.....	563,576	7.8	898,463	9.9	1,118,489	10.8
其他 ⁽¹⁾	-	-	2,564	0.0	31,767	0.3
合計	7,182,744	100.0	9,119,580	100.0	10,388,302	100.0

附註：

- (1) 其他包括光罩。

產能

在生產基地支持下，我們已建立晶圓代工能力。於2025年，我們的生產基地支持平均設計月產能約137.9千片12英寸晶圓。

下表載列我們的生產基地於所示年度的產能、產量及產能利用率：

	截至12月31日止年度								
	2023年			2024年			2025年		
	設計 產能 ⁽¹⁾	實際 產量 ⁽²⁾	產能 利用率 ⁽³⁾	設計 產能 ⁽¹⁾	實際 產量 ⁽²⁾	產能 利用率 ⁽³⁾	設計 產能 ⁽¹⁾	實際 產量 ⁽²⁾	產能 利用率 ⁽³⁾
	(千片)			(千片)			(千片)		
	(%)			(%)			(%)		
	1,320.5	957.4	72.5 ⁽³⁾	1,444.7	1,357.2	94.0	1,654.5	1,667.6	100.8

附註：

- (1) 我們的設計產能是一個綜合性的計算基準，其在綜合考慮特定工藝平台組合、設備的計劃性維護與潛在故障時間、新機台的正式投產時間以及瓶頸機台的工藝約束等因素後釐定。通過對這些變量的持續優化和運營管理，我們的實際產出可能超越靜態的設計產能目標。於往績記錄期間，我們開始使用新生產設備，以不斷擴大產能。於2023年、2024年及2025年，平均設計月產能(以相應年度的設計產能換算)分別為110.0千片、120.4千片及137.9千片。
- (2) 實際產量為特定年度內代工的晶圓實際數目。於2023年、2024年及2025年，平均實際月產量(以相應年度的實際產量換算)分別為79.8千片、113.1千片及139.0千片。
- (3) 年內產能利用率按實際產量除以同年設計產能計算。2025年，我們的產能利用率相對較高，主要因為市場需求上升。

見「業務—我們的生產能力」。

概 要

我們的晶圓代工服務

我們主要提供DDIC、CIS及PMIC的晶圓代工服務，而Logic IC及MCU於往績記錄期間迅速增長。該等集成電路是實現消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲器等多元終端市場關鍵功能的重要元件。於2023年、2024年及2025年，我們的晶圓總出貨量分別為935.9千片、1,366.6千片及1,624.7千片12英寸晶圓。

下表載列我們於所示年度按業務線劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
集成電路晶圓代工...	7,182,744	100.0	9,117,016	100.0	10,356,535	99.7
DDIC	6,090,289	84.8	6,155,358	67.5	6,031,364	58.1
CIS	433,399	6.0	1,574,237	17.3	2,352,195	22.6
PMIC	434,015	6.0	802,449	8.8	1,262,729	12.2
其他集成電路 ⁽¹⁾	225,041	3.2	584,972	6.4	710,247	6.8
其他 ⁽²⁾	-	-	2,564	0.0	31,767	0.3
合計	7,182,744	100.0	9,119,580	100.0	10,388,302	100.0

附註：

(1) 其他集成電路主要包括Logic IC、MCU及分立器件。

(2) 其他包括光罩。

見「業務－我們的晶圓代工服務」。

研究及開發

我們的研發能力是技術進步及業務增長的基石。在資深研發團隊的支持下，我們已在150nm至40nm主流技術節點建立自身研發實力，並完成28nm邏輯芯片平台的開發。我們的研發工作主要著重提升技術性能、拓寬應用平台及加速新技術產業化。

我們的持續研發投資及技術進步，為我們帶來知識產權組合，涵蓋半導體器件結構、製造製程、良率優化、能源效益及可靠性增強等關鍵技術領域。截至2025年12月31日，我們持有1,374項專利，其中包括1,057項發明專利，並持有354項專利申請，其中包括中國及其他司法權區的237項發明專利申請。

見「業務－研究及開發」。

概 要

營銷及銷售

下表載列我們於所示年度按地區劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
中國大陸	3,700,724	51.5	5,302,833	58.1	6,381,472	61.4
中國台灣	2,943,982	41.0	3,331,249	36.5	3,165,030	30.5
其他國家／地區 ⁽¹⁾	538,038	7.5	485,498	5.4	841,800	8.1
合計	7,182,744	100.0	9,119,580	100.0	10,388,302	100.0

附註：

(1) 其他國家／地區主要包括中國香港及新加坡。

見「業務－營銷、銷售及客戶」。

我們的客戶及供應商

於往績記錄期間，我們主要為無晶圓、輕晶圓及IDM公司等集成電路設計公司提供晶圓代工服務。來自往績記錄期間各年度五大客戶的收入分別為人民幣4,618.3百萬元、人民幣5,670.7百萬元及人民幣6,018.6百萬元，佔各年度總收入的64.2%、62.2%及57.9%。來自往績記錄期間各年度最大客戶的收入分別為人民幣1,394.7百萬元、人民幣1,663.8百萬元及人民幣2,322.6百萬元，佔各年度總收入的19.4%、18.2%及22.4%。

我們於往績記錄期間的收入集中於少數主要客戶，根據弗若斯特沙利文的資料，此情況與全球晶圓代工行業典型的高客戶集中度一致。這既反映我們與領先集成電路設計公司的牢固長期合作關係，亦體現行業對知名合資格供應商的依賴。關鍵客戶的收入波動主要源於半導體行業週期性、客戶存貨調整及下游市場競爭。我們通過擴大客戶群、豐富產品及技術平台以及拓展新應用場景以減輕有關風險。根據弗若斯特沙利文的資料，有關客戶集中情況符合行業常態。見「業務－營銷、銷售及客戶－我們的客戶」。

我們的供應商主要包括原材料及設備供應商。向往績記錄期間各年度五大供應商的採購額分別為人民幣1,395.3百萬元、人民幣1,528.6百萬元及人民幣1,864.8百萬元，佔相應年度採購總額的39.9%、34.9%及35.1%。向往績記錄期間各年度最大供應商的採購額分別為人民幣591.1百萬元、人民幣512.4百萬元及人民幣580.8百萬元，佔相應年度採購總額的16.9%、11.7%及10.9%。見「業務－我們的供應商」。

概 要

競爭

晶圓代工行業的競爭格局以高度集中及動態創新為特點，領先的全球及國內晶圓代工企業持續投資製程技術及產能擴張。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，2025年全球十大晶圓代工企業合共佔96.9%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，2025年我們為全球第九大晶圓代工企業及中國大陸第三大晶圓代工企業。根據同一資料來源，2020年至2025年期間，全球前十大晶圓代工企業中，我們的產能和營收增長速度為全球第一。我們在技術創新、製程優化、客戶參與及產能擴張方面的持續投資將使我們借助新興市場趨勢進一步鞏固我們在全球晶圓代工市場的領先地位。見「行業概覽」。

過往財務資料概要

下表呈列源自本文件附錄一會計師報告所載截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的合併損益及其他全面收益表及合併現金流量表以及截至2023年、2024年及2025年12月31日的合併財務狀況表的合併財務數據概要。以下資料及討論應與本文件附錄一會計師報告所載我們的合併財務報表及相關附註以及「財務資料」一節一併閱讀。

經營業績主要組成部分概述

下表載列於所示年度的經營業績摘要，以絕對金額及佔收入百分比列示：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
收入	7,182,744	100.0	9,119,580	100.0	10,388,302	100.0
銷售成本	(5,722,097)	(79.7)	(6,820,238)	(74.8)	(8,030,237)	(77.3)
毛利	1,460,647	20.3	2,299,342	25.2	2,358,065	22.7
其他收入	419,783	5.8	327,269	3.6	475,010	4.6
其他收益淨額	108,817	1.6	71,774	0.8	4,503	0.0
研發開支	(1,057,512)	(14.7)	(1,283,975)	(14.1)	(1,453,400)	(14.0)
一般及行政開支	(310,632)	(4.3)	(379,333)	(4.2)	(451,598)	(4.3)
銷售開支	(50,194)	(0.7)	(54,837)	(0.6)	(61,220)	(0.6)
就金融資產轉回／						
（確認）減值損失淨額...	106	0.0	1,750	0.0	(1,616)	(0.0)
融資成本	(451,674)	(6.3)	(496,641)	(5.4)	(375,667)	(3.6)
分佔聯營企業業績淨額..	—	—	(2,889)	(0.0)	(27,383)	(0.3)

概 要

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
除所得稅前利潤.....	119,341	1.7	482,460	5.3	466,694	4.5
所得稅費用.....	(176)	(0.0)	(263)	(0.0)	(196)	(0.0)
年內利潤.....	<u>119,165</u>	<u>1.7</u>	<u>482,197</u>	<u>5.3</u>	<u>466,498</u>	<u>4.5</u>
以下人士應佔年內利潤：						
本公司擁有人.....	211,629	2.9	532,841	5.8	704,204	6.8
非控股權益.....	(92,464)	(1.2)	(50,644)	(0.5)	(237,706)	(2.3)
	<u>119,165</u>	<u>1.7</u>	<u>482,197</u>	<u>5.3</u>	<u>466,498</u>	<u>4.5</u>

收入由2023年的人民幣7,182.7百萬元上升27.0%至2024年的人民幣9,119.6百萬元，主要得益於市場需求增加、豐富產品組合及規模經濟效應提升的共同推動。自2023年第四季度以來，隨著代工能力逐步擴展及市場需求恢復正常，對代工服務的需求開始上升。在此背景下，2024年收入增長主要由於CIS及PMIC產品市場需求的大幅增長，主要反映其於中高端智能手機及其他消費電子產品中的廣泛採用。收入由2024年的人民幣9,119.6百萬元進一步上升13.9%至2025年的人民幣10,388.3百萬元，主要由於集成電路晶圓代工服務產品銷售所得收入持續增加所致，此增長由市場對CIS及PMIC產品的持續需求，以及客戶對我們優質代工解決方案的認可度提升所帶動。

下表載列於所示年度按業務線劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
	(人民幣千元，百分比除外)					
集成電路晶圓代工...	1,460,647	20.3	2,298,876	25.2	2,345,421	22.6
其他 ⁽¹⁾	—	—	466	18.2	12,644	39.8
合計.....	<u>1,460,647</u>	<u>20.3</u>	<u>2,299,342</u>	<u>25.2</u>	<u>2,358,065</u>	<u>22.7</u>

附註：

(1) 其他包括光罩。

毛利由2023年的人民幣1,460.6百萬元上升57.4%至2024年的人民幣2,299.3百萬元。毛利率由2023年的20.3%上升至2024年的25.2%，主要由於客戶訂單及產量增加帶動規模經濟效應提高，設備、公共事業及其他生產資源得以更有效利用所致。

概 要

毛利由2024年的人民幣2,299.3百萬元上升2.6%至2025年的人民幣2,358.1百萬元。毛利率由2024年的25.2%下降至2025年的22.7%，主要由於自2024年以來我們加大技術平台多元化發展力度，推動新產品線的銷售增長。該等新產品仍處於增長階段，尚未達到足夠的規模經濟效益，導致其毛利率略低於DDIC等較成熟的產品。

淨利潤由2023年的人民幣119.2百萬元增加至2024年的人民幣482.2百萬元，主要由於客戶訂單及產量增加帶動規模經濟效應提高，設備、公共事業及其他生產資源得以更有效利用所致。我們的淨利潤保持相對穩定，於2024年及2025年分別為人民幣482.2百萬元及人民幣466.5百萬元。

見「財務資料—經營業績主要組成部分概述」。

合併財務狀況表的經選定項目

下表載列截至所示日期合併財務狀況表的經選定資料：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
非流動資產	36,210,954	40,654,714	45,753,244
流動資產	11,945,324	9,743,868	7,544,725
資產總值	48,156,278	50,398,582	53,297,969
非流動負債	12,001,514	16,883,847	19,948,849
流動負債	14,016,600	7,425,767	5,261,431
負債總額	26,018,114	24,309,614	25,210,280
流動(負債淨額)/資產淨值 ..	(2,071,276)	2,318,101	2,283,294
權益總額	22,138,164	26,088,968	28,087,689

截至2024年12月31日及截至2025年12月31日，流動資產淨值保持相對穩定，分別為人民幣2,318.1百萬元及人民幣2,283.3百萬元。現金及現金等價物有所減少，主要由於與收購廠房建築物及動力與基礎設施、採購設備及於聯營企業的投資有關的貿易及其他應付款項的結算，部分被償還到期借款及新借款減少使借款減少所抵銷。

我們於截至2024年12月31日錄得流動資產淨值人民幣2,318.1百萬元，而於截至2023年12月31日錄得流動負債淨額人民幣2,071.3百萬元，主要由於貿易及其他應付款項減少，主要原因為(i)收購非流動資產(包括機器設備以及廠房建築物及動力與基礎設施)的應付款項減少；及(ii)於相關合同責任獲履行後，我們執行退款程序或將該等按金抵銷2024年客戶訂單的應收金額導致已收按金減少，部分被預付款項、其他應收款及其他資產減少所抵銷，主要原因為我們根據理財策略減少固定收益憑證。

概 要

資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣26,089.0百萬元增加至截至2025年12月31日的人民幣28,087.7百萬元，主要由於(i)非控股股東注資人民幣1,400.0百萬元；(ii)年內全面收益總額人民幣706.8百萬元；及(iii)股份支付開支人民幣71.8百萬元所致，部分被已宣派股利人民幣194.4百萬元所抵銷。

資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣22,138.2百萬元增加至截至2024年12月31日的人民幣26,089.0百萬元，主要由於(i)年內全面收益總額人民幣513.3百萬元；(ii)非控股股東注資人民幣5,400.0百萬元；及(iii)股份支付開支人民幣20.1百萬元所致，部分被(a)非控股股東交易人民幣1,090.9百萬元；及(b)回購股份人民幣891.8百萬元所抵銷。

見「財務資料—若干主要資產負債表項目的討論」。

合併現金流量表概要

下表載列於所示年度的現金流量概要：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
經營活動(所用)／產生的現金流量			
淨額.....	(161,035)	2,761,132	3,842,920
投資活動所用的現金流量淨額.....	(9,026,732)	(11,806,729)	(10,279,968)
籌資活動產生的現金流量淨額.....	7,915,338	8,415,941	2,907,880
現金及現金等價物減少淨額.....	(1,272,429)	(629,656)	(3,529,168)
年初現金及現金等價物.....	7,736,337	6,506,676	5,826,895
匯率變動影響淨額.....	42,768	(50,125)	(21,107)
年末現金及現金等價物.....	6,506,676	5,826,895	2,276,620

於2023年，經營活動所用的現金流量淨額為人民幣161.0百萬元。來自經營活動的現金流量淨額與稅前利潤人民幣119.3百萬元之間的差額是由於以下各項所致：(i)非現金及非運營項目調整，主要包括物業、廠房及設備折舊人民幣2,875.5百萬元；及(ii)運營資金變動，主要包括(a)貿易及其他應付款項減少人民幣2,980.0百萬元；(b)貿易應收款項增加人民幣350.1百萬元；(c)存貨增加人民幣245.7百萬元；及(d)預付款項、其他應收款及其他資產增加人民幣63.1百萬元。於2024年及2025年，經營活動產生的現金淨額分別為人民幣2,761.1百萬元及人民幣3,842.9百萬元。

見「財務資料—流動資金及資本資源—現金流量」。

概 要

主要財務比率

下表載列於所示年度／截至所示日期的主要財務比率：

	截至12月31日止年度／ 截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
毛利率(%) ⁽¹⁾	20.3	25.2	22.7
淨利潤率(%) ⁽²⁾	1.7	5.3	4.5
權益回報率(%) ⁽³⁾	1.2	2.5	3.3
流動比率 ⁽⁴⁾	0.9	1.3	1.4
資產負債比率(%) ⁽⁵⁾	54.0	48.2	47.3

附註：

- (1) 毛利率等於年內毛利除以年內收入，再乘以100%。
- (2) 淨利潤率等於年內淨利潤除以年內收入，再乘以100%。
- (3) 權益回報率等於本公司擁有人應佔年內利潤除以本公司擁有人應佔年初及年末權益平均值，再乘以100%。
- (4) 流動比率按截至所示日期流動資產除以流動負債計算得出。
- (5) 資產負債比率等於截至所示日期負債總額除以總資產，再乘以100%。

見「財務資料—主要財務比率」。

風險因素

我們的業務及[編纂]涉及本文件「風險因素」一節所載的若干風險。我們面臨的若干主要風險包括：(i)我們所在的行業技術快速迭代，市場需求多變。倘我們未能適時採用新的製造技術、緊貼行業發展或適應瞬息萬變的市場，我們挽留現有客戶、吸引新客戶或維持市場競爭力的能力可能會受到不利影響；(ii)我們運營所在行業競爭激烈。倘我們無法與其他市場參與者有效競爭，我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到不利影響；及(iii)鑒於新技術平台需龐大[編纂]及漫長開發週期，我們的競爭力及財務表現可能會受到市場需求變化或我們[編纂]的採用率低於預期的不利影響。閣下於決定[編纂]股份前應細閱該節全文。見「風險因素」。

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，合肥建投控制本公司已發行股本總額約39.71%，包括直接擁有23.34%及透過合肥芯屏間接擁有16.37%，合肥芯屏的普通合夥人為建投資本，而建投資本則由合肥建投控制。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，合肥建投、建投資本及合肥芯屏將繼續控制本公司已發行股本總額超過30%，並將於[編纂]後繼續作為控股股東組別。

概 要

有關控股股東的進一步詳情，請見本文件「與控股股東的關係」一節。

此外，我們預期本集團與控股股東及／或其各自緊密聯繫人的若干關連交易將於[編纂]後繼續進行，有關詳情載於本文件「關連交易」一節。

我們於上海證券交易所上市

本公司現時於上海證券交易所科創板上市。董事確認，且中國法律顧問認為，自2023年1月1日起及直至最後實際可行日期，我們已於所有重大方面遵守適用於我們A股上市的所有中國法律及法規，且概無嚴重違反上海證券交易所規則以及中國其他適用證券法律及法規的情況，且據董事在作出一切合理查詢後所深知，概無任何有關上海證券交易所合規記錄的重大事項應提請投資者垂注。根據獨家保薦人進行的獨立盡職審查，獨家保薦人並無發現任何事宜以致其不同意董事就本公司於上海證券交易所科創板合規記錄所作確認。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，並假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及佣金以及估計開支後，我們估計將從[編纂]中收取[編纂]淨額約[編纂]港元。我們擬將[編纂][編纂]淨額用於以下用途：

- 預期[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於研發及優化新一代22nm技術平台，以加強我們的技術競爭力及滿足市場對高性能產品的需求。
- 預期[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於基於AI技術的智能研發及生產計劃。有關計劃旨在建立涵蓋研發至生產全流程的綜合智能系統平台，從而實現研發與生產的智能協作。
- 預期[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於在中國香港建立研發及銷售中心，以開展研發及銷售活動。
- 預期[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於運營資金及一般企業用途。

見「未來計劃及[編纂]用途」。

近期發展及無重大不利變動

自2025年12月31日以來，我們的業務運營及發展保持穩定。截至2026年2月28日止兩個月，我們的晶圓銷量超過0.3百萬片。董事確認，自2025年12月31日以來(最近期經審計財務報表結算日)及直至本文件日期，我們的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年12月31日以來，並無發生任何事件會嚴重影響本文件附錄一會計師報告所示資料。

概 要

[編纂] 統計數據

	按[編纂] 每股H股 [編纂]港元計算	按[編纂] 每股H股 [編纂]港元計算
股份[編纂] ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
每股未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值 ⁽²⁾⁽³⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) 本公司總[編纂]根據以下數據計算：(i)截至最後實際可行日期已發行的[1,945,503,197]股A股(未計及本公司購回的[62,088,500]股A股)，按截至最後實際可行日期的本公司A股收市價人民幣[24.04]元(相當於約[27.34]港元)計算；及(ii)緊隨[編纂]完成後預期將予發行的[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)。
- (2) 每股未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值乃作出本文件附錄二「未經審計[編纂]財務資料」一節所述調整後，基於緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股股份(未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)計算得出。
- (3) 經計及以下期後事件：非控股股東合肥建投向我們的附屬公司合肥皖芯注資人民幣1,600,000,000元的影響後，於2025年12月31日本公司擁有人應佔本集團每股未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值將分別為人民幣10.41元(11.84港元)及人民幣10.58元(12.03港元)，分別按[編纂]每股[編纂]港元及[編纂]港元計算。有關每股未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值的計算，見「財務資料—未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值報表」及本文件附錄二「未經審計[編纂]財務資料」。

股利及股利政策

於往績記錄期間，我們於2023年及2024年並無向股東宣派或派付任何現金股利，於2025年則宣派及派付現金股利人民幣194.4百萬元。有關我們的股利政策，見「財務資料—股利及股利政策」。

關稅、貿易限制及出口管制的影響

美國關稅的影響

於2025年12月23日，美國貿易代表辦公室(「美國貿易代表辦公室」)宣布將對自中國進口的半導體加徵關稅，初始關稅稅率為零，並將於18個月後(即2027年6月23日)上調，具體稅率將不遲於該日期前30天公布(「301條款關稅」)。另外，自2025年2月1日以來，特朗普總統對所有自中國進口的產品加徵關稅。於美國最高法院作出裁決後，按照美國政府發布的相關行政命令及官方通知，先前根據國際緊急經濟權力法(「IEEPA」)徵收的關稅已於2026年2月24日失效。取而代之，根據1974年貿易法第122條款徵收10%的臨時關稅，為期150天。因此，截至最後實際可行日期，於2026年2月24日IEEPA項下的關稅取消後，對自中國進口至美國的商品徵收10%的關稅。有關關稅安排屬臨時性質，仍視乎進一步監管發展及政策變動而定。

概 要

誠如美國出口管制及制裁法律顧問所告知，考慮到(i)於往績記錄期間，我們並無任何直接出口至美國的產品，且據我們所深知，我們並無向美國作出任何間接銷售；及(ii)自徵收該等關稅以來，概無客戶取消與我們的訂單，我們的訂單量、產品價格、客戶付款或物流安排亦無因美國關稅問題而出現任何重大不利變動，概無將關稅轉嫁予客戶，且董事預期美國關稅不會對我們的業務運營或財務表現產生任何直接或間接重大不利影響。

美國出口管制的影響

根據美國出口管理條例(「**出口管理條例**」)，來自美國商務部工業與安全局(「**工業與安全局**」)的許可證可能對涉及出口、再出口或在國內轉讓受出口管理條例規管的任何項目(包括商品、軟件及技術)提出要求。受出口管理條例規管的項目不僅包括在美國境內製造或位於美國境內的項目，亦包括若干外國製造的項目。此外，出口管理條例下的最新進展(包括「**超級計算機及半導體製造最終用途**」限制)旨在限制中國獲得先進計算及半導體製造技術。自2022年10月起，出口管理條例第744.23條向知悉或有理由知悉擬用於超級計算機或半導體製造最終用途的若干出口管理條例管制項目的出口商、再出口商或轉讓人施加許可要求，並隨時間分階段實施。

誠如美國出口管制及制裁法律顧問所告知，鑒於我們採購項目的性質、我們代工的產品及其擬定最終用途，董事認為超級計算機及半導體製造最終用途限制不大可能對我們的業務運營造成重大不利影響。此外，誠如美國出口管制及制裁法律顧問所告知，截至最後實際可行日期，本集團並無被列入美國實體清單或任何其他美國出口管制限制名單。於往績記錄期間，我們自美國或其他司法權區採購生產材料時並無面臨任何重大困難。我們的供應商並無告知我們供應安排的任何變動或中斷。我們的採購、研發及擴張活動如常進行。

國際制裁的影響

工業與安全局公布各種貿易限制清單，指定受指定項目出口或轉讓的特定許可證要求規限的人士、實體或政府。美國財政部海外資產控制辦公室(「**海外資產控制辦公室**」)存置的主要制裁清單為特別指定國民及被封鎖人員清單(「**特別指定國民清單**」)，其包括美國政府釐定涉及威脅或破壞美國國家安全或外交政策目標的活動的人士。特別指定國民清單上指定人士的資產被封鎖，且美籍人士一般被禁止與彼等進行交易。

我們的美國出口管制及制裁法律顧問認為，本集團於往績記錄期間的業務(特別是與客戶及供應商等交易對手的業務往來)並不構成主要制裁活動或次要制裁活動。見「**業務—關稅、貿易限制及出口管制的影響**」。

COVID-19疫情的影響

於2020年1月30日，世界衛生組織《國際衛生條例》突發事件委員會宣布2019新型冠狀病毒病(「**COVID-19**」)疫情構成國際關注的突發公共衛生事件，於2020年3月11日，世界衛生組織宣布全球COVID-19疫情大流行。於2022年，對電腦及平板電腦等電子產品的需求大幅增長，這由遠程工作及在線學習需求所帶動，從而

概 要

支持訂單量及定價上升，特別是在DDIC代工分部。於該需求增長期間後，半導體市場於2023年進入疫情後正常化階段，原因為下游客戶調整存貨水平，而需求動態恢復至更加正常化的模式。見「行業概覽 – 全球晶圓代工市場 – 全球集成電路市場規模」。

[編纂]開支

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數)，則估計我們應付的佣金及費用總額，連同聯交所[編纂]費、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費、法律及其他專業費用、印刷及[編纂]相關的其他開支合共約為人民幣[編纂]元，佔[編纂][編纂]總額的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)，其中約人民幣[編纂]元已或將自合併全面收益表扣除，約人民幣[編纂]元直接歸屬於我們的[編纂]的[編纂]及[編纂]，並將於[編纂]時自權益扣除。按性質劃分，[編纂]開支包括(i)[編纂]佣金約人民幣[編纂]元；及(ii)非[編纂]相關開支約人民幣[編纂]元，當中包括法律顧問及申報會計師的費用及開支約人民幣[編纂]元以及其他費用及開支約人民幣[編纂]元。